

Dezlipirea componentelor electronice

◀ lucrarea 1, nivel I, începători ▶

Pentru dezlipirea componentelor electronice de pe placa de circuit imprimat avem nevoie cam de aceleași unelte ca și la lipirea componentelor, adică:

Pensetă sau clește



În funcție de dimensiunea componentei care trebuie dezlipită, este necesar să se folosească o pensetă sau un clește pentru apucarea piesei electronice respective. În acest fel evităm accidentele (arsuri) și putem să ținem mai bine piesa respectivă în mâini.

Aliajul de lipire (fludor sau cositor)



Pentru dezlipirea componentelor se poate folosi fludor pentru a topi mai ușor aliajul deja întărit pe piciorușele componentei care urmează a fi dezlipită de pe PCB. Se va pune vârful stației de lipit pe fludorul întărit și se aplică fludor proaspăt pentru a grăbi procesul de dezlipire.

Tresa metalică



Tresa este folosită pentru a îndepărta fludorul de pe cablaj, aceste lipindu-se de ea. Această metodă nu îndepărtează în totalitate fludorul de pe cablaj și uneori nu putem dezlipi anumite componente doar cu ajutorul tresei și a stației de lipit.

Pompa de fludor



Această unealtă absoarbe fludorul topit de pe cablaj sau de pe piciorușele unei componente, funcționând ca și o seringă.

Stația de lipit cu reglaj de temperatură

Stația de lipit cu reglaj de temperatură este dispozitivul principal care se folosește atât la lipirea cât și la dezlipirea componentelor electronice. Cu ajutorul vârfului încins al stației, fludorul de pe terminalele componentelor se topește, astfel se poate scoate componenta din ansamblul format pe circuitul imprimat.

Realizarea corectă a unei dezlipiri de componentă electronică

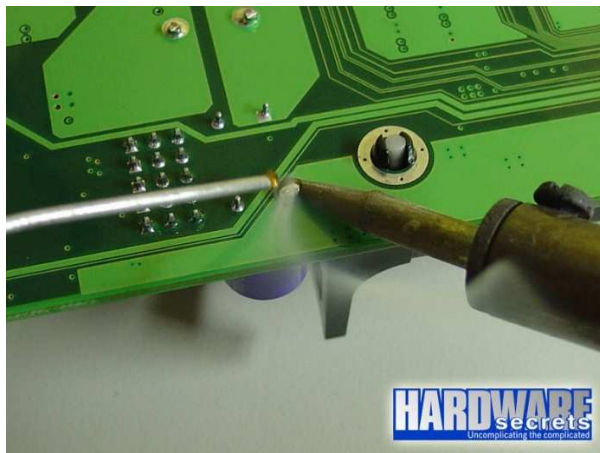
Pașii necesari pentru dezlipirea unei componente:

Metoda 1:

1. cu vârful letconului de lipire se atinge unul dintre terminalele lipite al componentei care trebuie dezlipită;
2. puneți fludor suplimentar pentru a accelera (mări) procesul de topire a fludorului întărit de pe piciorușe;
3. după topirea fludorului, cu ajutorul pensetei, scoateți cu atenție primul terminal din gaură, fără a distruge și încălzi foarte tare componenta;
4. faceți la fel și pentru al doilea terminal pentru a scoate complet piesa de pe placa de circuit imprimat.

Metoda 2:

1. cu vârful letconului de lipire atingeți unul dintre terminalele lipite ale componentei care trebuie dezlipită. Se poate aplica fludor suplimentar.



Topirea aliajului de pe terminal – imagine preluată de pe www.hardwaresecrets.com

2. așteptați până când fludorul devine lichid, apoi folosiți pompa de fludor pentru a elimina fludorul de pe terminal.



Dezlipirea cu ajutorul pompei – imagine preluată de pe www.onetesla.com

3. componenta ar trebui să fie mobilă după dezlipirea primului terminal.
4. repetați pașii 1 și 2 pentru al doilea terminal.

Metoda 3:

1. puneți tresă peste fludorul primului terminal;
2. atingeți și apăsați ușor cu vârful letconului peste tresă, aceasta va absorbi fludorul de pe picioruș;
3. pentru a curăța locul complet de fludor, folosiți o parte curată de tresă.
4. în urma curățării complete de fludor, componenta trebuie să fie mobilă (se mișcă în găuri).
5. repetați primii pași și pentru al doilea terminal pentru a dezlipi complet componentă electronică.



Dezlipirea cu ajutorul tresei – imagine preluată de pe www.safaribooksonline.com